

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2006-80564(P2006-80564A)

【公開日】平成18年3月23日(2006.3.23)

【年通号数】公開・登録公報2006-012

【出願番号】特願2005-336256(P2005-336256)

【国際特許分類】

H 01 L 25/18 (2006.01)

H 01 L 25/07 (2006.01)

H 01 L 25/065 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/08 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月1日(2007.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の半導体ベアチップを搭載する基材と、該基材に搭載した半導体ベアチップとを備えた半導体装置のパッケージ構造において、

マウントすべき半導体ベアチップの電極端子を接続する内部電極と、半導体ベアチップマウント後の試験時に試験装置の端子が接続される試験用電極と、半導体ベアチップをマウントしたのち前記基材に実装される時に他の部品に接続される実装用電極とを設けた半導体チップマウントサブ基板と、

前記半導体チップマウントサブ基板を、前記基材に搭載した半導体ベアチップの上部に配置するスペーサと、を備え、

前記半導体チップマウントサブ基板と前記基材に搭載された半導体ベアチップを前記基材とともに樹脂封止したことを特徴とする半導体装置のパッケージ構造。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

この発明は、複数の半導体ベアチップを搭載する基材と、該基材に搭載した半導体ベアチップとを備えた半導体装置のパッケージ構造において、

マウントすべき半導体ベアチップの電極端子を接続する内部電極と、半導体ベアチップマウント後の試験時に試験装置の端子が接続される試験用電極と、半導体ベアチップをマウントしたのち前記基材に実装される時に他の部品に接続される実装用電極とを設けた半導体チップマウントサブ基板と、

前記半導体チップマウントサブ基板を、前記基材に搭載した半導体ベアチップの上部に配置するスペーサと、を備え、

前記半導体チップマウントサブ基板と前記基材に搭載された半導体ベアチップを前記基材とともに樹脂封止したことを特徴としている。

## 【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】削除

## 【補正の内容】

## 【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】削除

## 【補正の内容】